

第一線の専門家が語る

IoTを支える材料・要素技術開発

～課題と将来展望～

主催 一般財団法人ファインセラミックスセンター

後援 経済産業省（予定）

一般社団法人日本ファインセラミックス協会

中部地域にはファインセラミックス分野の先導的研究機関・企業が集積しており、基幹産業の一つとしてその発展が期待されています。

当財団では、毎年、大学・企業の第一線の専門家をお招きし、ファインセラミックスの現状と将来動向に関するシンポジウムを開催してまいりました。

本年度は、『IoTを支える材料・要素技術開発』と題して、第一線でご活躍の方々に Society5.0 において重要な役割を担う IoT の動向と主要な要素技術であるイメージセンサ、エネルギーハーベスティング、チップ型二次電池、車載半導体センサについて、材料・要素技術開発における課題や将来展望をわかりやすくご講演いただきます。

多数の皆様がご参加くださいますようご案内申し上げます。

日 時 2019年10月25日（金）13:00～17:30

会 場 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）5F小ホール1

<プログラム>

13:00～13:05	開会挨拶
13:05～14:05	基調講演「ソフトバンクのIoT戦略 ～パートナーとの共創と次世代のIoT～」 ソフトバンク株式会社 IoT & AI 技術本部 IoT 技術戦略統括部 IoT 戦略部 アライアンス推進課 課長 神谷 義孝 氏
14:05～14:45	講演1 「Society5.0を進化させるイメージセンサ技術」 ソニー株式会社 主席技監 上田 康弘 氏
14:45～14:55	休憩
14:55～15:35	講演2 「エネルギーハーベスティングの最新動向と課題、今後の展望」 株式会社NTTデータ経営研究所 シニアマネージャー 竹内 敬治 氏
15:35～16:15	講演3 「チップ型セラミックス二次電池 EnerCera® シリーズのご紹介 －用途展開を中心に－」 日本ガイシ株式会社 執行役員 エレクトロニクス事業本部 ADC 事業部 事業部長 大和田 巖 氏
16:15～16:55	講演4 「デンソーにおける車載半導体センサと材料開発への取り組み」 株式会社デンソー 先端技術研究所 マテリアル研究所 課長 加納 一彦 氏
16:55～17:25	講演5 「高度画像解析技術と先端的電子顕微鏡技術の融合による ナノ計測インフォマティクス」 一般財団法人ファインセラミックスセンター ナノ構造研究所 主任研究員 山本 和生
17:25～17:30	閉会挨拶

<開催要項>

主催 一般財団法人ファインセラミックスセンター（JFCC）
後援 経済産業省（予定）
一般社団法人日本ファインセラミックス協会

日時 2019年10月25日（金）13:00～17:30
場所 愛知県産業労働センター ウィンクあいち 5F 小ホール1
<http://www.winc-aichi.jp/access/>
〒450-0002 名古屋市中村区名駅4丁目4-38



定員 200名（定員になり次第締切）

参加料 JFCC 賛助会員、学生、報道関係者：無料
上記以外（資料集代）：1,000円（消費税込み）

申込み方法 事前登録
JFCC のホームページ <http://www.jfcc.or.jp> からお申込み下さい。

参加証 当日、会場に名刺を1枚ご持参下さい。
※ 参加登録にご記入いただきました情報は、個人情報保護のもと本目的以外に使用いたしません。

申込み締切 10月22日（火） ※ 定員になり次第締め切ります。

申込み（一財）ファインセラミックスセンター 研究企画部
・問合せ先 〒456-8587 名古屋市中村区六野二丁目4番1号
TEL:052-871-3500 FAX:052-871-3599 E-mail:fcsympo2019@jfcc.or.jp